

信赖性试验

序号	试验项目	试验目的	试验条件
1	高压蒸煮测试 (AC/ PCT)	评估产品在高温、高湿、高压条件下的承受能力。	Ta=121°C, 100%RH, 2 atm
2	高温高湿 (HTHH)	评估试验产品在高温、高湿条件下的承受能力。	Ta=85°C, 85%RH
3	温度循环 (TC)	评估试验产品在高低温重复变化条件下的承受能力。	Ta=-55°C to +150°C 驻留时间: 30分钟
4	高温储存 (HTS)	评估试验产品在长时间高温条件下的承受能力。	Ta=150°C/ 175°C (press fit diodes)

信赖性试验（续）

序号	试验项目	试验目的	试验条件
5	低温储存 (LTS)	评估试验产品在长时间低温条件下的承受能力。	Ta=-40°C/ -55°C
6	耐焊接热 (SH)	评估试验产品在焊接过程中对瞬间高温的承受能力。	260+5/-0°C, 10±1 sec. 270±5°C, 7+2/-0 sec.
7	高温反偏 (HTRB)	评估试验产品在高温条件下，施加反向偏压的承受能力。	Ta=125°C/ 150°C/ 175°C, 80%VR
8	高温高湿反偏 (H ³ TRB)	评估试验产品在长时间高温、高湿条件下，施加反向偏压的承受能力。	Ta=85°C, 85%RH 80%VR up to 100V

信赖性试验（续）

序号	试验项目	试验目的	试验条件
9	间歇老化 (IOL)	评估试验产品在断续通电及温度剧烈变化条件下的承受能力。	$T_A=25^{\circ}\text{C}$, 5 min. on/5 min. off, $\Delta T_J \geq 100^{\circ}\text{C}$
10	热疲劳 (TF)	评估试验产品在重复高低温交替条件下的耐热疲劳能力。	$T_A=40^{\circ}\text{C}$ to 175°C On/Off=2/2 min.
11	可焊性 (Solderability)	评估试验产品引脚沾锡的能力。	$245 \pm 5^{\circ}\text{C}$, 5 ± 0.5 sec.
12	静电放电 (ESD)	评估试验产品承受静电放电冲击的能力。	$T_A=25^{\circ}\text{C}$ HBM ($C=100\text{pF}$, $R=1.5\text{K}\Omega$)
13	正向浪涌 (FS)	评估试验产品承受瞬间正向大电流的能力。	@8.3mS, 单半正弦波 叠加在额定负载